

財團法人工業技術研究院 函

機關地址：31057新竹縣竹東鎮中興路4段195號

承辦人：張綾珂

電話：03-5913797

電子信箱：lingkochang@itri.org.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國107年08月06日

發文字號：工研材字第1070013873號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：敬邀貴單位參加內政部建築研究所「建研所智慧化居住空間之需求與解決方案實務交流研討會」，隨函檢奉活動DM一份，請轉知所屬並派員踴躍參加，請查照。

說明：

- 一、本次研討會係本院執行內政部建築研究所107年度「智慧化居住空間整合應用計畫」中，將國內在建築與居住空間中導入數據運用的解決方案與實例，向與會相關領域人士報告分享並相互交流。
- 二、本計畫之實務交流研討會活動時間謹訂於107年8月16日(四)下午13:00~16:40台中場次(中科管理局工商服務大樓)，以及107年8月20日(一)下午13:30~16:40台北場次(內政部建築研究所材料實驗中心)，詳細活動內容及報名方式，請詳閱附件參訪活動DM。

正本：外交部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、勞動部、衛生福利部、文化部、科技部、國家發展委員會、行政院農業委員會、原住民族委員會、客家委員會、行政院公共工程委員會、行政院原子能委員會、行政院環境保護署、內政部警政署、內政部營建署、內政部消防署、中央警察大學、國立故宮博物院、臺北市政府、新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、基隆市政府、新竹縣政府、新竹市政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、嘉義市政府、屏東縣政府、宜蘭縣政府、花蓮縣政府、臺東縣政府、澎湖縣政府、金門縣政府、連江縣政府、國立政治大學、國立清華大學、國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立成功大學、國立中興大學、國立交通大學、國立中央大學、國立中山

總收文 107/08/06



副本：內政部建築研究所(含附件)